

# スパッタリング加工

ロール to ロールでフィルムや金属箔に  
金属薄膜を形成



## 【特長】

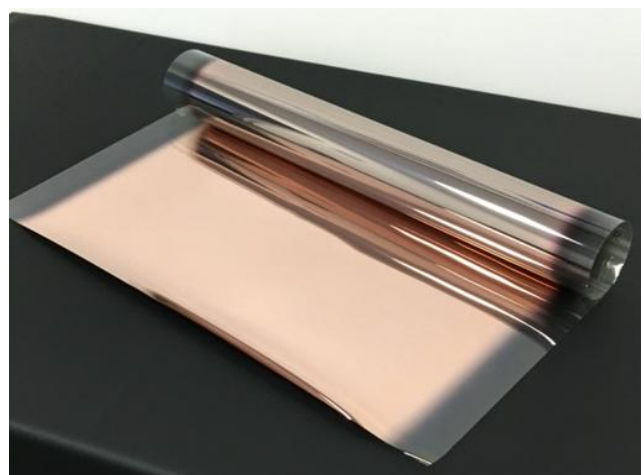
- ・ ロール to ロールでのスパッタリング処理により金属薄膜を形成  
(銅スパッタリングの例：厚み 0.1~0.2 $\mu$ m)
- ・ 銅、ニクロム合金、クロムのスパッタリングに対応  
(上記以外のターゲット材についてはご相談ください)
- ・ 基材にプラズマ前処理を組み合わせることで、密着力の向上が提案可能
- ・ 異なる金属種の連続製膜にも対応 (複数カソード使用)

## 【処理可能な基材仕様】

巻径	max $\Phi$ 350mm
重量	max 500kg
搬送可能幅	max 1,100mm
処理有効幅	max 1,000mm



スパッタリング装置外観



フィルム上への銅薄膜形成例

問合せ先 河村産業株式会社 <http://www.kawamura-s.co.jp>  
 本社・四日市工場 〒512-8052 三重県四日市市西大鐘町 330 番地 TEL (059) 337-1122  
 東京支店 〒110-0005 東京都台東区上野 1-18-9 黒門平成ビル5階 TEL (03) 5846-8228  
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-23-16 セントランドビル4階D室 TEL (06) 6476-7725